

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

上海润欣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2025年度业绩说明会)

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2026年05月15日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长郎晓刚先生，独立董事张育嘉先生，董事会秘书庞军先生，财务总监孙剑先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>上海润欣科技股份有限公司（本文简称“公司”）于2026年5月15日（星期五）下午15:00-17:00通过“价值在线”举办2025年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络互动方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下：</p> <p>Q1：（1）海普存储自产DDR5/SSD：出货量、客户认证、2026年放量计划？（2）AI眼镜项目：量产进度、与字节/小米合作、何时贡献营收毛利？（3）2026年一季度毛利率下滑原因及全年提升目标？</p> <p>答：你好，公司关注AI眼镜、语音卡等端侧AI智能终端的发展机会，并围绕低功耗主控SoC、智能音视频传感器及相关SDK方案持续布局。目前相关业务处于客户方案开发、样机验证及量</p>

产导入过程中。关于投资者关注的具体客户合作、量产节奏及订单情况，涉及客户商业安排和信息披露规则，公司不便对客户和具体项目作出确认或预测。若相关事项达到信息披露标准，公司将及时履行披露义务。从业绩贡献看，AI眼镜等新型AI终端仍处于产业发展早期，对公司收入和毛利的贡献存在不确定性。公司将继续发挥在芯片分销、方案设计和JDM服务方面的优势，积极把握端侧AI终端带来的业务机会，努力提升相关业务的规模和盈利能力。谢谢。

Q2：请问今年的分红计划？

答：尊敬的投资者，您好！公司2025年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本512,521,047股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共分配现金股利10,250,420.94元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。2025年度，公司累计现金分红总额为17,943,734.77元（含已实施完毕的2025年度中期分红及本次拟实施的2025年度分红），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.49%。感谢您对公司的关注！

Q3：数字通讯芯片及方案增长最快，今年还能保持高增速吗？

答：2025年公司无线连接与系统方案增长较快，主要得益于公司在低功耗主控SoC和系统级应用方案方面的业务增长，也反映出市场对端侧AI化、低功耗连接和场景化方案的需求持续提升。2026年，公司围绕AI音视频终端、AI语音卡在端云一体化上的新产品机会，推动从单一芯片分销向“芯片+模组+方案+JDM服务”延伸。公司对该业务的高增速持积极态度，具体增长会受到客户项目量产进度和新技术结构变化等因素影响。公司将努力把新的产品机会转化为收入增长和盈利能力提升。谢谢。

Q4：汽车电子业务增长明显，今年客户和订单拓展情况怎么样？

答：汽车电子是公司重点关注的方向之一。2025年该业务增长较快，主要来自公司在功率器件、模拟器件、分立器件上的产品布局和车载客户服务的多年积累。2026年公司会继续推进汽车电子、工业控制和新能源等客户及项目拓展。谢谢。

Q5：今年研发投入方向？

答：你好，根据年报披露，公司研发投入将继续围绕自身的优势细分领域展开，重点聚焦低功耗主控SoC、智能音频传感及系统级应用方案。从研发结构上，公司研发从之前做芯片驱动、嵌入式、BSP集成，逐渐转向围绕平台/SDK集成，提供客户量产交付能力。谢谢。

Q6：今年新客户拓展顺利吗？

答：总体来说，公司的新客户拓展进展顺利。公司围绕端侧AI新产品机会、海外品牌等方向，持续加强客户开发和项目导入。部分项目目前处于客户认证、和量产导入过程中，后续将根据客户的市场节奏逐步推进，争取实现营收增长和盈利提升。谢谢。

Q7：有什么新品落地吗？

答：你好，今年公司的新产品落地，主要围绕一个方向：端侧AI带来的新终端机会。谢谢。

Q8：海外市场发展如何？

答：尊敬的投资者您好，针对海外市场发展，公司已经规划构建“本地研发+区域性市场枢纽+友岸仓储”的供应链架构，平衡地缘关税与汇率风险，提升公司主营业务的核心竞争力。面对国际贸易环境变化、区域关税调整、汇率波动及地缘政治等不确定因素，公司将进一步完善区域协同和风险分散机制，提升主营

	<p>业务韧性和持续经营能力，感谢您对公司的关注。</p> <p>Q9：咱们这个行业竞争压力大吗？</p> <p>答：谢谢关注，半导体芯片行业，谁都不容易！公司会努力在竞争压力中提升自己的生存能力和盈利能力，体现出公司从“芯片技术销售”，向“芯片+方案设计+JDM交付”转型升级的产业链价值。</p> <p>Q10：今年海外市场会加大拓展力度吗？</p> <p>答：海外市场拓展是公司今年的重点工作之一，公司将围绕海外销售渠道、产品认证与专利池，积极推进海外新型终端客户开发和项目落地。谢谢。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年05月15日